分子イオン注入エピウェーハの製品特性(4) -フラッシュランプ熱処理による注入欠陥の結晶性回復挙動解析-

Characteristic of Molecular Ion Implanted Epitaxial Wafers (4) -A Study of Recrystallization of Implantation-related Defect Using Flash Lamp Annealing-株式会社 SUMCO

⁰小林 弘治, 奥山 亮輔, 柾田 亜由美, 重松 理史, 廣瀨 諒,門野 武,古賀 祥泰,奥田 秀彦,栗田 一成 SUMCO CORPORATION

^oKoji Kobayashi, Ryosuke Okuyama, Ayumi Masada, Satoshi Shigematsu, Rvo Hirose, Takeshi Kadono, Yoshihiro Koga, Hidehiko Okuda and Kazunari Kurita E-mail: kkobayas@sumcosi.com

1. はじめに

我々は、CMOS イメージセンサの高性能化のため炭素クラスターイオン注入技術による近接ゲッタリング技術 の開発をおこなってきた. 炭素クラスターイオン注入エピタキシャルウェーハは, 重金属に対する高いゲッタリング 能力と、基板酸素のデバイス活性領域への外方拡散抑制効果、さらに注入領域に捕獲された水素による界面 準位等に対するパッシベーション効果の3つの特徴を有している¹⁾. これらの特徴は注入ドーズ量の増加により向 上することが報告されてきた²⁾.しかしながら,高ドーズ注入条件では,注入レンジ中にアモルファス層が形成され, 表層近傍の結晶性が低下するためにエピタキシャル欠陥が発生する. エピタキシャル欠陥の低減のためには回 復熱処理が必要となるが、従来の縦型炉や急速急冷熱処理炉(Rapid Thermal Anneal: RTA)ではアモルファス 層の再結晶化時に欠陥が形成される3).本報告では、ミリセカンドの極短時間熱処理が可能なフラッシュランプア ニール(Flash lamp anneal: FLA)に着目し、アモルファス層の再結晶化に FLA が与える影響の解析をおこなっ たので報告する.

2. 実験方法

p型 Si(100)基板に C₃H₅の炭素クラスターイオンを加速電圧 80keV/cluster, 炭素ドーズ量 2.0E15 atoms/cm² となるように注入した. その後, FLA 処理を処理温度 1100℃, 処理時間 1.4msec にておこない, 5µm のエピタキ シャル層を成長させた.サンプル評価として、FLA 後および、エピタキシャル成長後の注入領域の断面 Transmission electron microscope(TEM)観察をおこなった.

3. 実験結果

Fig.1にクラスター注入後の(a)FLA 処理無し, (b)FLA 処理有りサンプルの注入領域の断面 TEM 像を示す. FLA 処理無しサンプルでは表層から深さ 30~60nm にアモルファス層が形成されているが, 1.4msec の FLA 処理 においてもアモルファス層が再結晶化することが観察された. さらに, Fig.2に(a)FLA 処理無し, (b)FLA 処理有り サンプルのエピタキシャル成長後における注入領域の断面 TEM 像を示す. FLA 処理無しサンプルでは, エピタ キシャル層/基板界面から 50nm の深さにアモルファス層の再結晶化起因のサイズ 20~30nm の欠陥が形成され ている.この欠陥は、エピタキシャル工程において、アモルファス層が表面側と基板側の両方向から再結晶化し たため,格子不整合が生じ,形成されたと考える.一方で, Fig.2(b)の FLA 処理後にエピタキシャル成長をおこな ったサンプルでは, アモルファス起因の欠陥が観察されなかった. このことは FLA 処理ではアモルファス層の再 結晶化過程が異なっていることを示している. したがって, FLA によりクラスター注入領域のアモルファス層に起 因した欠陥形態の制御が可能であることが示唆される結果を得た.



Fig.1 XTEM image of C₃H₅-cluster-ion-implanted (a)without FLA, (b)with FLA

[参考文献]

- 1) K. Kurita et al, Phys. Status Solidi A, 1700216 (2017) / DOI 10.1002/pssa.201700216
- 2) K. Kurita et al, Jpn. J. Appl. Phys, 55(2016)121301 / DOI 10.7567/JJAP.55.121301
- 3) R. Okuyama, et al, Jpn. J. Appl. Phys, **57**(2018)011301 / DOI 10.7567/JJAP.57.011301

Interface of epi / Si sub

